

## 群聯電子 2023 年第三季 合併財報 與 10 月份營收 公告

本公司除揭露金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)<sup>註1</sup> 財務資訊外，另補充非金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)<sup>註1-2</sup> 財務資訊(請參閱附表【補充資訊】)，其僅為補充而非替代資訊，且最終實際盈餘分配依照金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)的財務數據為準，提醒財務報告閱讀人特別注意。

### 2023 年第三季：金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)財務資訊

- 本季合併營業收入淨額為新台幣 123.89 億元，較前季增加 23.8%，較去年同期減少 15%。
- 本季合併毛利率為 32.2%，較前季減少 0.3 個百分點，較去年同期增加 7.8 個百分點。
- 本季合併營業利益為新台幣 5.25 億元，較前季減少 26.8%，較去年同期減少 57%。
- 本季合併本期淨利為新台幣 8.58 億元，每股盈餘為新台幣 4.32 元。

#### 合併營業收入

本公司 2023 年第三季之合併營業收入淨額為新台幣 123.89 億元，較前季增加 23.8%，較去年同期減少 15%。

#### 合併營業毛利及毛利率

本季合併營業毛利為新台幣 39.89 億元，較前季增加 22.7%，較去年同期增加 12.1%。本季合併毛利率為 32.2%，較前季減少 0.3 個百分點，較去年同期增加 7.8 個百分點。

#### 合併營業費用

本季營業費用為新台幣 34.64 億元(佔營業收入 28%)，前一季營業費用則為新台幣 25.33 億元(佔營業收入 25.3%)，去年同期營業費用為新台幣 23.38 億元(佔營業收入 16%)。

本季營業費用主要項目包括：

- ◆ 研究發展費用新台幣 28.96 億元(佔營業收入 23.4%)，高於前一季之新台幣 19.83 億元(佔營業收入 19.8%)，高於去年同期之新台幣 17.86 億元(佔營業收入 12.3%)。
- ◆ 推銷費用新台幣 3.25 億元(佔營業收入 2.6%)，高於前一季之新台幣 3 億元(佔營業收入 3%)，高於去年同期之新台幣 3.22 億元(佔營業收入 2.2%)。
- ◆ 管理費用新台幣 2.38 億元(佔營業收入 1.9%)，高於前一季之新台幣 1.90 億元(佔營業收入 1.9%)，高於去年同期之新台幣 2.09 億元(佔營業收入 1.4%)。

### 合併營業利益與營業利益率

本季營業利益為新台幣 5.25 億元，較前季減少 26.8%，較去年同期減少 57.0%。本季營業利益率為 4.2%，低於前一季之 7.2%；亦低於去年同期之 8.4%。

### 合併營業外收支與所得稅

本季營業外淨利益為新台幣 4.27 億元，佔營業收入 3.4%。主要係綜合認列外幣兌換利益及認列透過損益按公允價值衡量之金融資產利益之結果。本季所得稅費用為新台幣 0.94 億元。

### 合併本期淨利、淨利率及每股盈餘

本季本期淨利為新台幣 8.58 億元，較前季增加 94.7%，較去年同期減少 28.0%。本季淨利率為 6.9%，高於前一季之 4.4%；低於去年同期之 8.2%；每股盈餘為新台幣 4.32 元，高於前一季之 2.28 元；低於去年同期之 6.13 元。

### 合併現金及透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動

本季現金及按公允價值衡量之流動金融資產合計為新台幣 153.29 億元，佔總資產的 25.4%，前季現金及按公允價值衡量之流動金融資產合計為新台幣 133.66 億元，去年同期現金及按公允價值衡量之流動金融資產合計為新台幣 144.75 億元。按公允價值衡量之流動金融資產包含基金、國內上市櫃股票及衍生性商品等相關金融商品投資。

### 合併應收帳款

本季應收帳款淨額合計為新台幣 85.99 億元，平均應收帳款週轉天數 67 日(以本季平均應收帳款淨額及當期銷貨收入年化為計算基礎)，高於前季之 63 日；亦高於去年同期之 50 日。

### 合併存貨

本季存貨淨額合計為新台幣 213.31 億元，平均存貨週轉天數 259 日(以本季平均存貨淨額及當期銷貨成本年化為計算基礎)，低於前季之 274 日；高於去年同期之 163 日。

註 1. TIFRS 為 Taiwan-International Financial Reporting Standards 縮寫。

註 2. 非金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)為金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)之補充而非替代資訊，調節項目為股份基礎給付獎勵及所得稅影響數等，細節請參閱附表補充資訊。

## 2023 年 10 月份營收與出貨

10 月份合併營收為新台幣 51.59 億元，較前月成長達 3% (MoM)，為歷史同期次高；年度累計至 10 月份營收達新台幣 376.33 億元，與去年同期相較成長達-27% (YoY)。

與去年同期相比，10 月份 PCIe 控制晶片總出貨量年增率達 290% (YoY)，其中 PCIe SSD 儲存模組總出貨量年成長達 110% (YoY)，創歷史單月新高。此外，儲存位元數總出貨量 (Total Bit Shipment) 年增率也達 100%，為歷史單月新高。

## 市場近況摘要

隨著 NAND 原廠自 2022 年第四季開始減產，並自 2023 年第二季擴大減產以及系統廠商庫存歷經 3 至 4 個季度的消化後，NAND 儲存市場已逐漸因為回補庫存等需求緩步回溫，進而帶動 NAND 市場價格的回穩甚至漲價；再者，根據市調機構數據，全球 NAND 儲存市場產值將在 2025 年達到近 850 億美金以上（相較於 2023 年的全球 NAND 儲存市場產值約為 350 億美金）。換言之，NAND 儲存市場可能在未來的季度維持相對穩定的成長及需求。

## 群聯擬預付貨款以確保 NAND 原廠貨源供應

由於 NAND 原廠減產以及降低資本支出等因素，群聯 2023 年第四季已出現部分 NAND 原物料供貨吃緊情況，再加上為因應市調機構預估 2024 年景氣需求回溫走升等因素，因此，群聯擬透過預付貨款予 NAND 供應商的方式，強化與 NAND 供應商的合作與穩定貨源，確保群聯於未來季度能滿足全球客戶與夥伴的 NAND 儲存產品需求。

## 群聯擬發行國內第二次無擔保轉換公司債用於研發支出與擴大營業規模

有鑑於 NAND 控制晶片逐漸進入先進製程世代（例如群聯旗艦的 PCIe 5.0 SSD 控制晶片 E26 採用 12nm 製程，新一代的 PCIe 5.0 DRAM-Less SSD 控制晶片 E31T 採用 7nm 製程等），再加上 NAND Flash 技術的持續演化以及全球客戶的各種客製化系統加值服務合作案等因素，因此群聯擬發行第二次的無擔保轉讓公司債 (Unsecured Convertible Bonds) 約新台幣 60 億元，預計將用於研發支出及擴大營業規模等，以確保群聯技術的領先地位。相信這些策略的布局，再加上群聯以 IC 設計為基底的系統加值設計服務營運模式，將有助群聯掌握下一波的成長商機。

**【補充資訊】**  
**非金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)**  
**財務資訊調節表**

新台幣/百萬元		3Q23	2Q23	3Q22	Q/Q (%)	Y/Y (%)
TIFRS	營業利益	525	717	1,221	(26.8%)	(57.0%)
	營利率(%)	4.24%	7.17%	8.38%		
調節項目	股份基礎給付酬勞成本	342	66	85		
Non-TIFRS	營業利益	867	783	1,306	10.7%	(33.6%)
	營利率(%)	7.00%	7.82%	8.96%		

TIFRS	稅後淨利	858	441	1,192	94.6%	(28.0%)
	淨利率(%)	6.93%	4.40%	8.18%		
	基本每股盈餘 (NT\$)	4.32	2.28	6.13		
調節項目	股份基礎給付酬勞成本	342	66	85		
	所得稅影響數	(72)	(19)	(18)		
Non-TIFRS	稅後淨利	1,128	488	1,259	131.1%	(10.4%)
	淨利率(%)	9.10%	4.88%	8.64%		
	基本每股盈餘 (NT\$)	5.68	2.52	6.39		

### [群聯公告暨新聞稿訂閱]

如欲獲取群聯新聞稿或其它公告，請訂閱：[群聯投資人關係訊息訂閱](#)

### [關於群聯的關鍵數字]

- 超過 23 年的快閃記憶體控制晶片暨儲存方案整合經驗
- 全球超過 3800 位員工，且 70%以上為工程師
- 全球近 2000 個 NAND 記憶體相關專利
- 透過 5+5 長期發展大戰略，驅動長期千億級營收
- SSD 控制晶片全球市佔率超過 20%
- 2022 年全年度營收超過\$602.56 億新台幣
- 群聯除了與日本 KIOXIA（原 TMC 東芝記憶體）有長期合作之外，群聯與全球主要的 NAND 原廠也均是長期合作的夥伴關係
- 群聯**獨特的營運模式**，讓群聯能在 NAND 產業的劇烈變化下，能仍維持穩定的獲利及成長

### [關於群聯電子]

群聯電子 (Phison Electronics Corp.) 長期耕耘於快閃記憶體控制器晶片領域，是全球 NAND 儲存控制晶片 (NAND Controller) 及儲存解決方案 (NAND Storages) 領導廠商。從 IP 技術授權、晶片設計、系統架構解決方案、系統整合至成品，為不同需求的客戶提供最佳的產品與服務。在各項產品類別上，包括 SSD (PCIe/SATA/PATA)、UFS、eMMC、SD 與 USB 介面，皆可提供完整的存儲解決方案。

歡迎拜訪 [群聯網站](#) 或 [群聯 Q&A](#) 以更了解群聯電子。

#### 群聯電子發言人

于紹庭 Antonio Yu

TEL: 037-586-896 #10019

Mobile: 0979-105-026

Email: [antonioyu@phison.com](mailto:antonioyu@phison.com)

#### 群聯電子代理發言人

呂國鼎 Kuo-Ting Lu

TEL: 037-586-896 #26022

Mobile: 0979-075-330

Email: [kuoting\\_lu@phison.com](mailto:kuoting_lu@phison.com)

### [預測性陳述聲明]

本新聞稿所提供之資訊(除歷史資訊之外)屬於預測性陳述。在此敬告讀者，預測性陳述乃基於群聯之合理認知以及就現狀所作的預估，且將受到各種風險以及不確定因素影響，因此可能造成實際結果和預測性陳述之內容顯著不同。這些風險以及不確定性因素包括但不限於，供給與需求變化、產銷能力、開發成功、及時導入市場、市場競爭、產業循環、客戶財務狀況、匯率浮動、法律訴訟、法令變更、全球經濟變化、自然災害、其他可能會影響群聯業務與營運的不確定因素。鑑於此，讀者請勿倚賴預測性陳述。除法律另有規定外，無論是基於新資訊、未來事件或是其他因素，群聯皆無義務更新預測性陳述。